**第五届华进开放日报名表**

**5th NCAP OPEN DAY REGISTRATION FORM**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称****Company** |   |
| **公司行业分类****Company Industry Classification** | 装备/Equipment□ 材料/Material□ 设计/Design□ 终端/End user□ 封测/OSATs□ 代工/Foundries□ 整合元件制造/IDM□ 资讯/Consulting□ 媒体/Media□大学/University□ 其他/Other□ |
| **企业会员类型****Company Membership** | 🞐FOPLP联合体二期项目会员/ 2nd Phase FOPLP Consortium Member🞐国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟会员/National Technology Innovation Strategic Alliance for IC Assembly and Testing Member🞐江苏省半导体行业协会会员/Jiangsu Semiconductor Industry Association Member |
| **门票价格****Ticket Rate** | 1. **上述三类会员单位**：免费
2. **非上述三类单位**：500元/人
 |
| **参会代表****Name** | **职务****Title** | **门票价格****Ticket Rate** | **邮箱****Email** | **参加晚宴****Dinner** | **手机号****Mobile** |
|  |  | 🞐Free 🞐500  |  | 🞐是 🞐否 |  |
|  |  | 🞐 Free 🞐500 |  | 🞐是 🞐否 |  |
|  |  | 🞐 Free 🞐500 |  | 🞐是 🞐否 |  |
|  |  | 🞐 Free 🞐500 |  | 🞐是 🞐否 |  |
|  |  | 🞐 Free 🞐500 |  | 🞐是 🞐否 |  |
| **会议联系人****Contact** |  | **邮箱****Email** |  | **手机号****Mobile** |  |
| **付款信息/Payment Information****（开票信息请另附/please provide your billing information in another file）** |
| 公司名称：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司公司地址：无锡市新区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园D1栋账 号：10635001040222409银行名称：中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行银行地址：无锡新发汇融商务广场2号 |

**（注：本表填写后发电子邮件给我们，报名截止日期 11月4日；现场签到时，请出示名片，谢谢！）**